

公司代码：688035

公司简称：德邦科技

烟台德邦科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及除解海华之外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	解海华	因个人原因协助监察机关调查暂不能履职	无

5 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为 14,224.00 万股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 42,672,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为 34.69%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	德邦科技	688035	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	于杰	翟丞
办公地址	山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号（C-41小区）	山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号（C-41小区）
电话	0535-3469988	0535-3467732
电子信箱	dbkj@darbond.com	dbkj@darbond.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于高端电子封装材料的研发及产业化，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，可实现结构粘接、导电、导热、绝缘、保护、电磁屏蔽等复合功能，是一种关键的封装装联功能性材料，广泛应用于晶圆加工、芯片级封装、功率器件封装、板级封装、模组及系统集成封装等不同封装工艺环节和应用场景。

由于不同应用场景对电子封装材料所需实现的具体功能、技术要求存在较大差异，引致具体产品在技术标准、客户群体、市场竞争格局等方面均存在较大区别，因此行业惯例一般根据产品的应用领域、应用场景进行产品分类。据此，公司产品分类为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。

2022年，公司主营业务收入构成情况如下表所示：

单位：万元

产品类别	2022年		2021年	
	金额	占比	金额	占比
集成电路封装材料	9,427.18	10.22%	8,352.26	14.35%
智能终端封装材料	18,207.93	19.74%	17,940.63	30.82%
新能源应用材料	59,019.27	63.98%	26,737.45	45.93%
高端装备应用材料	5,592.31	6.06%	5,183.78	8.90%
合计	92,246.68	100.00%	58,214.12	100.00%

2022年，公司集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料收入合计占比为93.94%，在高端电子封装领域保持较高的收入占比，同时凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已进入到众多知名品牌客户的供应链体系。

公司不同类别产品具体情况如下：

1、集成电路封装材料

集成电路封装材料贯穿了电子封装技术的设计、工艺、测试等多个技术环节，并直接制约下游应用领域的发展，属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业环节，是先进封装技术持续发展的基础，是半导体封装的关键材料，直接影响晶圆、芯片及半导体器件的良率和质量。

集成电路封装材料的技术难点主要在于，集成电路封装对材料的理化性能、工艺性能及应用性能综合要求极高，必须满足集成电路封装的特殊工艺要求。一般情况下，集成电路器件在高温高湿处理后需要能耐受 260℃无铅回流焊，并要求封装材料没有脱层、不龟裂、不损伤芯片等，同时封装好的集成电路器件须通过高温、高湿、老化等可靠性的系列测试。要达到以上工艺性和可靠性的要求，封装材料对不同材质的粘接性、韧性、弹性、强度都有特定要求。在功能性方面，集成电路封装材料一般带有导电、导热、屏蔽以及光敏等特殊功能。此外在高纯度、超低卤含量以及超低重金属含量要求也均有不同的需求。

公司致力于为集成电路封装提供晶圆固定、导电、导热、保护及提高芯片使用可靠性的综合性产品解决方案，并持续研发满足先进封装工艺要求的系列产品，开发出集成电路封装领域的关键材料。

2、智能终端封装材料

公司的智能终端封装材料广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等移动智能终端的屏显模组、摄像模组、声学模组、电源模块等主要模组器件及整机设备的封装及装联工艺过程中，提供结构粘接、导电、导热、密封、保护、材料成型、防水、防尘、电磁屏蔽等复合性功能，是智能终端领域封装与装联工艺最为关键的材料之一。

智能终端封装材料的技术难点主要在于，随着智能终端产品高度集成化、微型化、轻薄化、多功能化、大功率化等发展趋势，对封装材料耐环境老化、抗跌落冲击、防水、耐汗液、低致敏以及对环境和人体无害等要求不断提升。封装材料必须具有高粘接性、高柔韧性和高抗冲击性的平衡，耐水、耐油、耐汗液、环保、低致敏，符合不断提升的人体健康及环境保护质量标准，并可适用于多种固化工艺。

3、新能源应用材料

新能源应用材料主要应用于新能源汽车动力电池、光伏电池、消费电池、储能电池等领域，属于绿色能源应用领域的关键材料。

①在新能源汽车动力电池领域，双组份聚氨酯结构胶等动力电池封装材料主要用于电池电芯、电池模组、电池 Pack 起到粘接固定、导热散热、绝缘保护等作用，在动力电池大模组化、无模组化的发展趋势下，传统结构件已不再适用，动力电池封装材料是取代传统结构件实现动力电池轻量化、高可靠性的关键材料之一。由于汽车长期处于高震动、高湿度、高温度的工作环境，应用场景非常复杂，长使用寿命、高安全性能需求对材料带来非常严苛的可靠性要求，满足汽车应用技术标准的车规级材料从研发至产业化上市的过程具有技术含量高、耗时较长的特点。动力电池封装材料的技术难点主要在于，需要同时具备：A.优异的抗低频振动性等可靠性，以提升电池寿命；B.优异的导热性与阻燃性，以保证安全性；C.较小的电池质量，以满足动力电池的轻量化要求。

②在光伏电池领域，光伏叠晶材料可以为高效叠瓦组件提供粘接、导电、降低电池片间应力等功效，并应用于大尺寸及中小尺寸的光伏电池，是实现光伏叠瓦封装工艺、实现高导电性能、高可靠性的关键材料之一。光伏叠晶材料的技术难点主要在于，在叠瓦封装的应用环境下，光伏叠晶材料需要满足：A.特殊的高导电率要求，接触电阻稳定性高；B.材料的初固和终固强度较高，耐机械载荷，耐室外环境老化，以提升叠瓦组件产品的可靠性；C.湿热和低温环境下组件功率衰

减低；D.优化产品工艺性能如细度、流动性，提升材料印刷性能；E.更高纯度封装材料的使用有助于提高导电效率。

③在储能电池领域，聚氨酯结构胶用于电池模组和电池系统起到固定、密封、绝缘和导热的作用。储能电池封装材料的技术难点主要在于，A.耐高温性，满足电池系统在高温环境下运行的需求；B.耐腐蚀性，满足电池系统在酸碱、电解液腐蚀等特殊环境的使用要求，并具有优异的导电性和导热性；C.具有较低接触电阻、稳定的导电性能、良好的机械强度和抗震动性，确保电池系统的稳定性和可靠性，以及长期使用寿命等优异性能。

④在消费电池领域，消费锂电封装材料具备多项特性，起到保证锂电池的安全、可靠和稳定的作用。消费电池封装材料的技术难点主要在于，A.需要具有良好的耐化学性能力，以防止锂电池内部多种强腐蚀性物质分解或腐蚀；B.需要具有良好的耐高温性能力，以避免在高温环境下失效或变形；C.需要具有良好的电绝缘性能力，以防电隔离不良或短路；D.需要具有足够的抗拉强度，以保证锂电池内部器件的完整性和稳定性；E.材料成分不能含有任何有害物质，以满足环保和健康的要求。

4、高端装备应用材料

除集成电路、智能终端、新能源行业外，公司产品在轨道交通、汽车制造等高端装备应用领域亦有广泛应用。在汽车制造领域，汽车制造用材料能够锁紧咬合金属螺纹，或是填充组件间间隙，达到组件结合目的，同时具备大间隙固化、耐高温、良好的力学性与稳定性等良好特点。在轨道交通领域，高铁用粘接材料以其优良的粘接性，突出的耐油性、耐冲击性、耐磨性、耐低温等特性在高铁建设中得到了广泛的使用。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等与合格供应商签订年度框架合同或直接下发订单。公司通过市场情况、向供应商询价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

对于研发、生产部门提出的新材料采购需求，采购部门根据原材料技术规范录入 ERP 系统，并更新技术规范目录，如研发仓无库存，则通过供应商名录中的现有供应商或寻找符合要求的新材料供应商并进行筛选，通过试样、现场稽核、生产能力评估等供应商考察程序，最终纳入采购日常维护管理体系。物料需求产生时，采购部根据物料清单确定物料库存，做出采购计划，向合格供应商进行采购。

2、生产模式

公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，以保证生产计划与销售情况相适应。销售部根据市场需求量，提供月度、季度、年度产品销售预测并确保准确率。综合管理部根据销售预测制定年度、季度、月度、周生产计划，并分析市场需求波动及生产计划达成情况，及时调整生产计划。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。在生产经营过程中，各部门紧密配合，确保降低因客户订单内容、需求变动以及交期变动、产销不平衡等原因而造成的损失。

公司以银粉、银铜粉等粉体材料类，多元醇、有机硅树脂、丙烯酸酯、多异氰酸酯等基体树脂类，离型膜、PET 膜等基材膜、固化剂等助剂为原材料，以针筒、胶桶等为辅助包装材料，以电力为主要能源供应，以反应釜、涂布机等工艺设备为主要生产设备，为客户提供应用于不同封装工艺环节的高端电子封装材料。

3、销售模式

公司产品的销售模式包括直销模式、经销模式。公司设有专门的销售部门，具体负责产品的市场开拓、营销、与市场部的对接以及售后服务等营销管理工作。部分客户因对产品的性能需求较高，要求对其供应链体系进行管控，公司产品需要通过客户在可靠性、功能性、苛刻环境耐受性等方面的验证测试，方能进入其供应商名录，以获取订单。

（1）直销模式

根据下游主要重点客户的分布情况，公司形成了以山东及江浙沪为中心的华东销售网络和以宁德、深圳为中心的华南销售基地，并在不断拓展其他销售区域的客户。公司主要通过老客户推荐、服务商推荐、参加展会及潜在客户咨询等方式开拓客户。客户直接采购模式下，直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。公司在客户签收产品后，公司根据经双方确认的对账单确认收入。境外直销模式下，在货物已经报关出运，在取得经海关审验的产品出口报关单时，客户取得货物控制权，公司确认收入。对于部分直销客户，应其库存管理及响应要求，公司采用寄售销售模式，具体流程为：公司在收到客户发货通知后，按照通知要求在约定的时间内将货物运至客户指定仓库指定存放区域；货物入库前，双方对合同货物的数量、规格、型号、外观包装等进行查验，确认货物数量、规格型号无误、外观无破损。入库后，客户按照实际需求领用货物，公司在客户实际领用并取得客户对账确认的凭据时确认销售收入。

（2）经销模式

公司的经销模式为买断式经销。报告期内，公司经销收入系通过签署经销协议的授权经销商进行。为进一步拓展市场和客户资源，提升公司产品市场覆盖率，公司选取部分有市场经营和客户资源基础的合作方发展为经销商。公司与经销商签署经销协议，对经销商所服务的客户范围及销售的产品范围等进行管理。

经销模式下，经销商具有较为高效的客户管理能力，可以更好地满足需求变化较快且订单较为零散的中小客户的需求以及供货要求及时的部分大客户的需求。利用经销商模式，公司可以节约销售资源及人力成本，使公司销售资源主要集中于终端核心客户，提高销售效率，扩大了公司产品的市场覆盖率和知名度。对于经销客户，公司将货物发至客户后，在取得客户签收确认的凭据时确认销售收入。

4、研发模式

对于集成电路封装领域、智能终端领域的客户，因终端产品门类繁多且迭代较快，不同客户所选用的技术路径、生产工艺存在较大差异，因此对于所适配高端电子材料的性能要求也有所不同。高端电子材料生产企业需要持续升级技术、快速调整配方，以满足市场和客户的要求，对于技术储备、研发水平和创新能力要求较高。

高端电子封装材料属于配方型产品，公司以自主研发、自主创新为主，同时，公司与高校、客户等外部单位建立了战略合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发模式一方面以客户需求为导向，为客户提供定制化材料，另一方面紧紧跟随市场行业界的技术发展路线图，建立适应产业需求的产品及技术平台，同时通过介入客户终端产品设计，凭借对产品配方的技术储备、产品快速迭代改良、客户适配，形成了较强的市场竞争力；公司建有应用及理化分析测试验证技术平台，能够快速对产品工艺性和模拟器件的可靠性开展测试验证，加快产品定型和在客户端的导入。

公司重视研发投入，已建立完善的研发体系，规范了新产品从立项、产品设计开发、过程设计开发以及到最终量产等各阶段的管理要求，同时为实现研发项目高效管理与运行，公司导入了产品生命周期管理信息化平台（即：PLM系统），PLM系统的二期建设将于2023年下半年正式启动，建立以项目流程为主线结构化数据管理，实现项目可视化进度管控，提升协同研发效率，缩短研发周期，以支持公司针对多样、持续迭代的应用需求，实现灵活快速的研发响应。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是从事高端电子封装材料研发及产业化，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，产品广泛应用于集成电路封装、智能终端封装、光伏组件封装和动力电池封装等新兴行业领域，行业涵盖领域广、应用行业跨度大，是新材料产业体系中的前沿、关键材料领域，是支撑中国制造实现突破的基础之一，对我国集成电路、智能终端、光伏制造、新能源电池等产业发展具有显著的助力作用，是我国重点支持和发展的行业之一。

从全球市场竞争格局来看，在封装材料领域，国外发达国家起步较早，技术发展较快，具有一定的先发优势和规模优势，在全球封装材料市场中占有较大份额。

目前高端电子封装材料市场主要为德国汉高、富乐、陶氏化学等欧美厂商以及日东电工、日本琳得科、日本信越、日立化成等日本厂商所占据，相比而言，国内产业起步较晚，核心技术水平相对落后，虽然目前我国的封装材料产量已跃居世界前列，但主要以生产通用型和中低档的封装材料为主，高附加值的封装材料品种的产量比例还是很低，且品种单一，与国外同类产品相比，在质量上还有较大的差距。因此，利用共聚、共混复合、接枝、交联、互穿网络、紫外光辐射等技术，开发具有优良耐水性、耐候性、耐高温、高强度、高阻燃性等高性能和高附加值新型封装材料，将成为我国封装材料的研发热点和市场新的利润增长点。（数据来源：中研网）

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内高端电子封装材料行业的先行企业。公司坚持自主可控、高效布局业务策略，聚焦集成电路、智能终端、新能源等战略新兴产业核心和“卡脖子”环节关键材料的技术开发和产业化。公司致力于为行业领先客户持续提供满足前沿应用需求及先进工艺要求的系列产品，凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已进入到众多知名品牌客户的供应链体系。具体而言：

1、集成电路封装材料方面，与国际先进水平相比，国内目前仍存在较大的技术差距，开发方面处于弱势，相关封装材料主要依赖进口。公司的芯片固晶导电胶等芯片固晶材料产品，覆盖MOS、QFN、QFP、BGA和存储器等多种封装形式，已通过通富微电、华天科技、长电科技等国内多家知名集成电路封测企业验证测试，并实现批量供货。根据行业公开信息，除公司外，国内供应商仅有长春永固实现产品供货。但相比国际竞争对手，公司市场份额目前仍相对较低。公司的晶圆UV膜产品从制胶、基材膜到涂覆均拥有完全自主知识产权，亦已在华天科技、长电科技、日月新等国内多家知名集成电路封测企业通过产品认证并批量供货。根据行业公开信息，除公司外，暂未有其他拥有自主知识产权并实现产品批量供货的国内供应商。但相比国际竞争对手，公司市场份额目前仍相对较低。公司的芯片级底部填充胶、Lid框粘接材料、芯片级导热界面材料等产品目前正在配合国内领先芯片半导体企业进行验证测试，与此同时，公司还承担了集成电路领域国家重大科技、重点科研项目等，对于集成电路材料国产化进程起到了一定的推动作用。

2、智能终端封装材料方面，国内供应商在技术研发上已取得长足进步，在中低端领域已占据主要份额，但在国内外知名品牌供应链的高端应用领域，汉高乐泰、富乐、戴马斯、陶氏化学等国外供应商仍处于主导地位。公司的智能终端封装材料产品已进入国内外知名品牌供应链并实现大批量供货，与国外供应商全面展开直接竞争，并已在TWS耳机等部分代表性智能终端产品应用上逐步取得了较高的市场份额。除公司之外，亦有其他国内供应商在品牌客户部分产品的部分用胶点上实现销售，但在多品类产品上实现大批量供货、并与国外供应商全面展开直接竞争的国内厂商仍相对偏少。

3、动力电池封装材料方面，在宁德时代、比亚迪等动力电池厂商的带动下，国内动力电池产业链整体处于国际领先地位，公司攻克各项技术难点，基于核心技术研发的动力电池封装材料产品作为高能量密度、轻量化的关键材料之一，已陆续通过宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、蜂巢能源等众多动力电池头部企业验证测试，并持续配合下游客户前沿性的应用技术需求，快速迭代研发，产品具有较强的竞争优势、市场份额处于前列。

4、光伏叠瓦封装材料方面，作为先进封装技术的代表，叠瓦技术可大幅提升组件功率，行业内企业积极推进叠瓦组件的技术研发。在通威股份、隆基股份、阿特斯等光伏组件厂商带动下，国内光伏组件产业链处于国际领先地位。针对叠瓦封装工艺的技术难点，公司基于核心技术研发的光伏叠晶材料，已大批量应用于通威股份、阿特斯等光伏组件龙头企业，产品具有较强的竞争优势、市场份额处于前列。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

“十四五”规划以来，我国封装材料行业的发展迅速，自动化的生产要求、产品的迭代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都推动了封装材料行业的健康、稳定、可持续发展。目前我国封装材料市场呈现出以下特点：

1、国内产品技术水平和质量明显提升，逐步进军中高端产品市场，替代进口产品；

2、5G 通信、新能源汽车、复合材料、智能终端设备等新兴市场对封装材料产品的需求强劲增长，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级；

3、随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型封装材料产品受到市场的青睐和重视，是封装材料行业技术更迭的主要方向；

4、高污染、高能耗的落后生产企业相继被淘汰，龙头企业竞争力持续提升，行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。

未来几年，欧美经济发展将逐步恢复，对封装材料需求量稳步提高。同时受到亚洲等新兴国家经济快速发展的影响，封装材料市场发展迅速。但由于欧美市场基本偏向于饱和，欧洲封装材料需求量增速在 1.2%左右，北美封装材料需求量增速维持在 2.1%左右，全球需求量会保持稳定增长，但增速较慢。据预测，2022-2026 年全球封装材料需求量保持年均 3%的速度增长，到 2026 年全球封装材料需求量或达 2,880 万吨。

国内封装材料行业虽起步较晚，但近年来保持着较快的发展势头。目前，高端电子封装材料行业受到国家重点支持，政策导向对行业发展有强力的指导作用，给行业发展带来了更大的机遇，对公司等有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。在部分中高端产品细分市场，国产封装材料正以显著的性价比和本土化服务优势逐步替代进口产品，抢占市场份额，出现共同竞争的局面。面对全球市场对中高端封装材料的巨大需求，国内封装材料企业仍有较大的发展空间。预计“十四五”末，我国封装材料产品将改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，行业附加值将进一步提升，由粗放的规模扩张型发展向更高质量的效益提升型发展转型。（数据来源：中研网）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	2,583,417,309.40	824,275,736.37	213.42	499,306,516.12

归属于上市公司股东的净资产	2,205,120,896.30	594,631,812.06	270.84	398,505,919.98
营业收入	928,520,323.32	584,334,374.64	58.90	417,165,304.62
归属于上市公司股东的净利润	123,005,835.36	75,885,892.08	62.09	50,149,936.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,286,071.88	63,395,382.45	58.19	41,408,484.56
经营活动产生的现金流量净额	-82,904,554.07	12,390,066.12	-769.12	15,827,729.57
加权平均净资产收益率(%)	11.97	14.41	减少2.44个百分点	13.43
基本每股收益(元/股)	1.0643	0.7227	47.27	0.50
稀释每股收益(元/股)	1.0643	0.7227	47.27	0.50
研发投入占营业收入的比例(%)	5.03	5.25	减少0.22个百分点	5.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	175,008,684.74	200,829,188.49	257,041,525.96	295,640,924.13
归属于上市公司股东的净利润	17,165,580.31	26,507,493.89	39,281,469.57	40,051,291.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,161,590.84	22,378,731.75	38,057,996.54	23,687,752.75
经营活动产生的现金流量净额	-25,091,829.45	-2,306,485.89	-15,191,066.62	-40,315,172.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								6,966
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								6,756
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								不适用
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	26,528,254	18.65	26,528,254	26,528,254	无	0	国有法人
解海华	0	15,064,154	10.59	15,064,154	15,064,154	无	0	境内自然人
林国成	0	13,208,201	9.29	13,208,201	13,208,201	无	0	境内自然人
王建斌	0	8,661,115	6.09	8,661,115	8,661,115	无	0	境内自然人
新余泰重投资管理中心(有限合伙)	0	8,555,326	6.01	8,555,326	8,555,326	无	0	其他
烟台康汇投资中心(有限合伙)	0	5,939,050	4.18	5,939,050	5,939,050	无	0	其他
烟台德瑞投资中心(有限合伙)	0	5,724,379	4.02	5,724,379	5,724,379	无	0	其他

北京三行资本管理有限责任公司—苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,402,581	2.39	3,402,581	3,402,581	无	0	其他
民生证券—中信证券—民生证券德邦科技战略配售 1 号集合资产管理计划	0	3,276,322	2.30	3,276,322	3,276,322	无	0	其他
陈田安	0	3,093,256	2.18	3,093,256	3,093,256	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成存在一致行动关系；烟台康汇投资中心（有限合伙）和烟台德瑞投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为解海华；除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

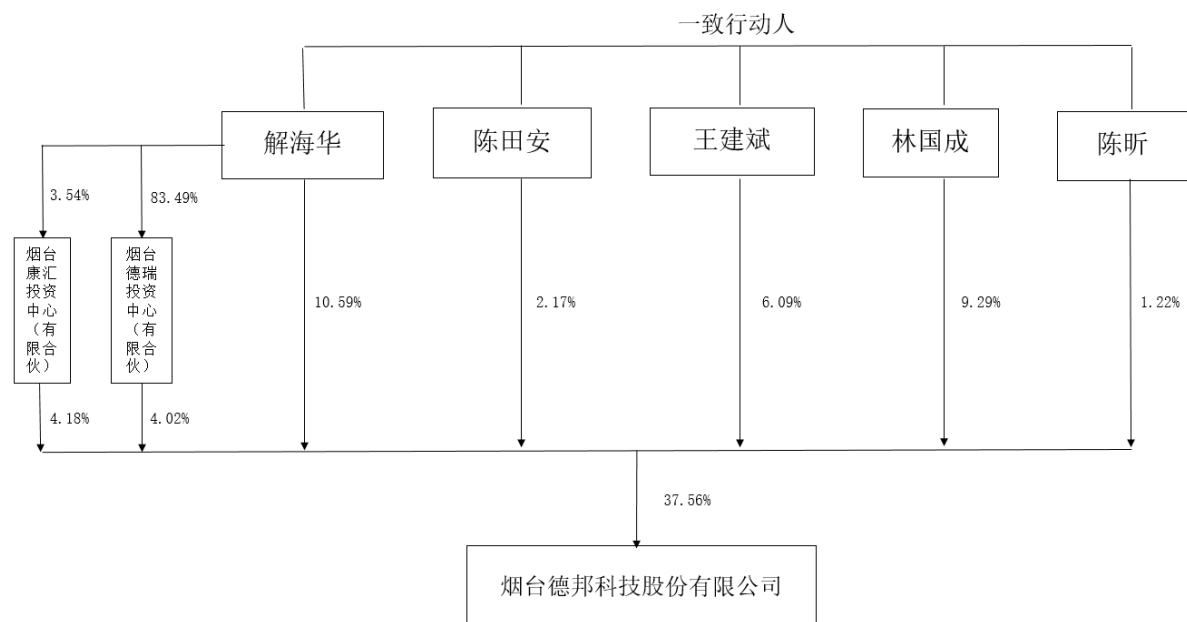
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

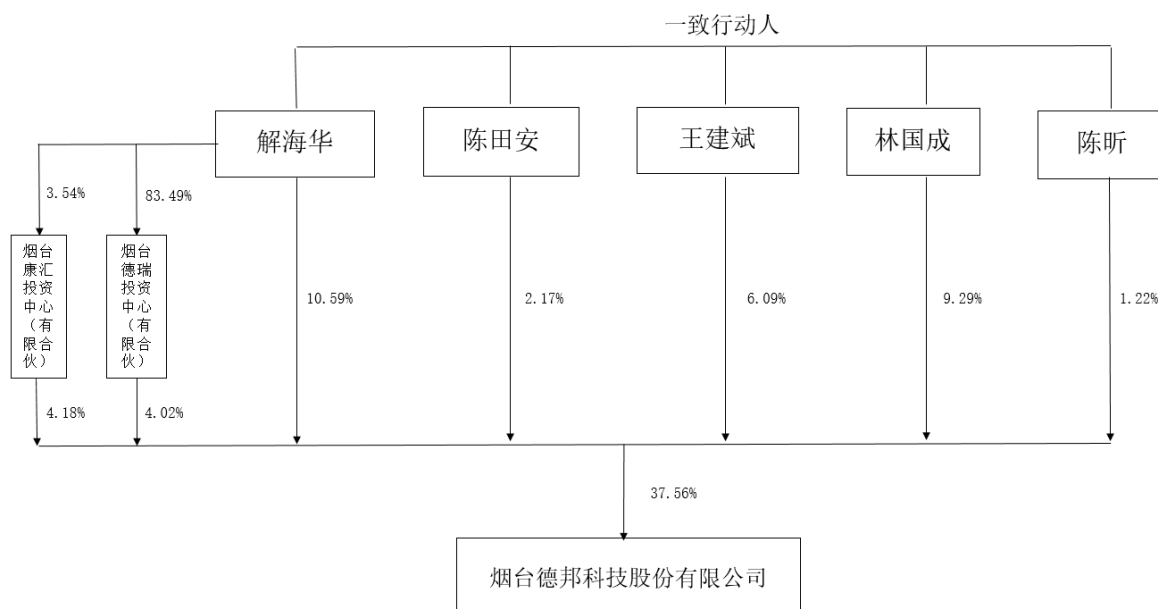
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年公司实现营业收入 9.29 亿元，较上年同期增长 58.90%，连续几年实现较快增长；实现归属于母公司所有者的净利润 1.23 亿元，较上年同期增长 62.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用